

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-058

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于以结构性存款等资产质押申请开具银行承兑汇票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、业务概述

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年银行综合授信的议案》，同意公司向银行申请总额不超过169,000.00万元人民币综合授信，具体内容详见公司于2024年2月5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年银行综合授信的公告（更正后）》（公告编号：2024-013）。

为提高资金使用效率，降低资金成本，公司拟以公司名下的未到期的单位定期存单、企业大额存单、结构性存款以及银行承兑汇票等金融资产质押，向交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请开具不超过人民币20,000.00万元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。额度内可循环使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

二、审议和表决情况

2024年4月19日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议表决通过了《关于以结构性存款等资产质押申请开具银行承兑汇票的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

向银行质押结构性存款等资产并开具等额银行承兑汇票符合公司实际业务情况及经营发展需要，能有效提高资金使用效率，降低资金成本，从而提升公司盈利能力，不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。

四、备查文件

《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日